

25W用	ラスター彫刻					ベクター彫刻				
	パワー	スピード	PPI	パス	深さ	パワー	スピード	PPI	パス	深さ
アルマイド処理アルミ	54	80	500	1	0.0254	12	4	1000	1	0
大理石	100	46	500	1	0.0762	24	4	500	1	0.1
アクリル樹脂(浅い)	40	80	500	1	0.0254	6	4	1000	1	0.3
アクリル樹脂(深い)	100	33	500	1	0.254					
アクリル樹脂(切断)						90	0.4	1000	1	5.1
ラバースタンプ	100	13	500	1	0.762	60	1.3	90	1	1
コルク	80	50	500	1	0.254	12	4	500	1	0.3
コルク(切断)						60	1.6	100	1	1.5
木材	100	33	500	1	0.508	80	4.2	500	1	0.8
木材(切断)						50	1.6	250	1	3.2
デルリン	100	29	500	1	0.381					
デルリン(切断)						75	2	200	1	1.5
厚紙・マットボード	54	80	250	1	0.127	24	4	250	1	0.1
厚紙・マットボード(切断)						60	3.2	200	1	1.3
人工大理石(浅い)	100	33	500	1	0.127	60	4	1000	1	0.3
人工大理石(深い)	100	17	1000	1	0.381					
ガラス	100	17	300	1	0.0254	10	3.3	300	1	0
メラミン(浅い)	100	33	500	1	0.381	24	4	500	1	0.3
メラミン(深い)	100	23	500	1	0.508					
皮革	34	80	500	1	0.0254	6	4	500	1	0.3
皮革(切断)						50	1.7	200	1	2.5
二層板(RAWMRK)	40	100	500	1	-	100	10	500	3	-

#### ワンポイント アドバイス

ベクター切断時、完全に切り落とすことも出来ますが上記の設定は厚みの80%程度の切れ込みを入れるようになっています。これは切状態で保つためです。加工終了後に手で切り離してください。

ベクター切断時に完全に切り落としてしまいたい時は、上記のスピード設定は5~5.5倍にし、パスを10回程度にしてください。

これは、1回のパスで切断できる設定にすると切断面が溶けるなどの弊害が起こるためです。**但し、切り落とす時は極力ハニカム加工して材料を浮かした状態で切断してください。**これはレーザーの輻射による材料裏面の溶解・汚れを防ぐためです。

ベクター切断時にカット部分の淵が汚れますが、切り離す前に乾いたティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。  
また、表面が白色のタイプで汚れが落ちにくい場合は、事務用のプラスティック消しゴムで軽くこすってください。

文字の部分を残して周りをラスター加工する場合(広範囲のラスター加工)は熱収縮による材料のソリ(変形)が起こります。極力、文字ようにしてください。

レーザーライト (裏面シールタイプ)	ラスター彫刻					ベクター切断(シール台紙は切断しない)				
	パワー	スピード	PPI	パス	深さ	パワー	スピード	PPI	パス	深さ
	25	34	100	500	1	80	40	500	1	-
					ベクター切断(シール台紙も切断する)					
					パワー	スピード	PPI	パス	深さ	
					80	40	500	2	-	

#### ワンポイント アドバイス

ベクター切断時にカット部分の淵が汚れますが、切り離す前に乾いたティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。

文字の部分を残して周りをラスター加工する場合(広範囲のラスター加工)は熱収縮による材料のソリ(変形)が起こります。極力、文字ようにしてください。